

DIN EN 60749-15

ICS 31.080.01

Ersatz für
DIN EN 60749-15:2003-10
Siehe Anwendungsbeginn

**Halbleiterbauelemente –
Mechanische und klimatische Prüfverfahren –
Teil 15: Beständigkeit gegen Löttemperatur bei Bauelementen zur
Durchsteckmontage
(IEC 60749-15:2010);
Deutsche Fassung EN 60749-15:2010 + AC:2011**

Semiconductor devices –
Mechanical and climatic test methods –
Part 15: Resistance to soldering temperature for through-hole mounted devices
(IEC 60749-15:2010);
German version EN 60749-15:2010 + AC:2011

Dispositifs à semiconducteurs –
Méthodes d'essai mécaniques et climatiques –
Partie 15: Résistance à la température de soudage pour dispositifs par trous traversants
(CEI 60749-15:2010);
Version allemande EN 60749-15:2010 + AC:2011

Gesamtumfang 11 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2010-12-01 angenommene Europäische Norm als DIN-Norm ist 2011-06-01.

ANMERKUNG Das auf dem Titelblatt der EN angegebene Annahmedatum der EN 2010-12-10 beruht auf einem Zahlendreher, der nach Aussage von CENELEC aber nicht korrigiert wird.

Diese Norm enthält die Berichtigung EN 60749-15:2010/AC:2011.

Daneben darf DIN EN 60749-15:2003-10 noch bis 2013-12-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60749-15:2009-06.

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 631 „Halbleiterbauelemente“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 47 „Semiconductor devices“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date) unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „<http://webstore.iec.ch>“ zu dieser Publikation angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Die in der Norm enthaltene Berichtigung EN 60749-15:2010/AC:2011 besagt, dass im Vorwort der EN 60749-15:2010 der Satz „Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt.“ zu streichen ist.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 60749-15:2003-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) redaktionelle Änderungen im Anwendungsbereich;
- b) Verweis auf IEC 60068-2-20 als normativer Verweis gestrichen;
- c) Ergänzung von Festlegungen für die chemische Zusammensetzung bleifreier Lote;
- d) redaktionelle Überarbeitung der deutschen Sprachfassung;
- e) der Anhang ZA ist entfallen.

Frühere Ausgaben

DIN 41794-1: 1972-06

DIN IEC 60749: 1987-09

DIN EN 60749: 2000-02, 2001-09, 2002-09

DIN EN 60749-15: 2003-10

– Leerseite –